

Amkor 宣布在美国建立先进封装与测试工厂

Amkor 在亚利桑那州新建先进封装工厂，打造富有弹性的国内半导体供应链

亚利桑那州坦佩市— 2023 年 11 月 30 日 — 领先的半导体封装和测试服务提供商 Amkor Technology, Inc. (纳斯达克股票代码: AMKR) 宣布, 计划在亚利桑那州皮奥里亚建造一座先进的封装和测试工厂。到项目全部竣工时, Amkor 预计将投资约 20 亿美元, 在新工厂雇用 2000 多名员工。

Amkor 拥有先进的封装技术能力和大批量生产经验。竣工后, 这将是美国最大的外包先进封装工厂。

Amkor 总裁兼首席执行官 Giel Rutten 说: “美国半导体供应链的扩张正在进行中, 我们很高兴能在提升美国先进封装能力方面发挥带头作用。” “半导体公司、代工厂和其他供应链合作伙伴了解战略性扩大其地理覆盖范围的必要性。我们宣布在亚利桑那州新建先进封装和测试工厂, 这清楚地表明我们打算帮助客户确保弹性供应链, 并成为强大的美国半导体生态系统的一部分。”

在最近的[国会证词](#)中, 商务部长 Gina M. Raimondo 强调, 先进封装是美国政府重建美国半导体制造业的一个主要重点领域。美国商务部明确表示, 发展强大的先进制造能力是首要任务, 也是 CHIPS 计划成功的关键。

Amkor 已获得约 55 英亩的土地, 打算建设一个拥有超过 500000 平方英尺无尘车间的最先进制造园区。制造工厂的第一阶段的目标是在未来两到三年内投入生产。Amkor 计划为半导体的先进封装和测试提供大批量前沿技术, 以支持高性能计算、汽车和通信等关键市场。

Amkor 与苹果公司就皮奥里亚工厂的战略愿景和初步制造能力进行了密切合作, 该工厂将位于当地的台积电工厂附近, 为苹果公司生产的芯片进行封装和测试。当新工厂开业时, 苹果公司将成为其第一个也是最大的客户。

Amkor 于 1984 年首次进驻大凤凰城地区, 并很高兴能在不断发展的亚利桑那州半导体行业中扩大业务范围。新的生产基地将使 Amkor 独一无二地跻身于由前端晶圆厂、IDM 和供应商组成的强大生态系统中, 这些厂商目前在该地区已经拥有或正在扩大业务范围, 包括 TSMC、Intel、Applied Materials、ASML 等。

该项目已获得皮奥里亚市、亚利桑那州商务主管部门和政府当局的大力支持, 扩大了大凤凰城都市区不断发展的半导体生态系统, 提供了高科技就业岗位, 增加了经济活力。

为确保在美国成功实施如此大规模的项目, Amkor 申请了 CHIPS 资金。制定《CHIPS 和科学法案》的目的是提高美国半导体行业的竞争力、创新力和国家安全。作为 527 亿美元计划的一部分, 联邦政府将向美国公司发放 390 亿美元的竞争性补助金, 为制造商提供资金, 以资助设施和设备的建设、扩建和现代化。这些资金对于 Amkor 项目的推进至关重要。

亚利桑那州参议员 Mark Kelly 表示: “Amkor 的 20 亿美元项目是亚利桑那州自去年通过《CHIPS 法案》以来宣布的最大微芯片投资项目之一, 将创造高薪工作岗位, 提振当地经济, 并有助于保护国家安全。” “作为美国首批先进封装工厂, 这是减少微芯片供应链中对其他国家/地区依赖的巨大进步。在谈判《CHIPS 和科学法案》时, 我的首要任务之一就是确保 Amkor 这样的公司能够获得在亚利桑那州等地开发有弹性供应链所需的支持, 这些公司在将微芯片制造业带回美国方面处于领先地位。”



新闻稿

亚利桑那州州长 Katie Hobbs 表示：“Amkor 的宣布对亚利桑那州来说是历史性的一步，它将加强美国的国家安全，建立更具弹性的供应链，为我们州带来数十亿美元的收入，并为亚利桑那州的工人创造数千个高薪就业岗位。”“该项目是美国在先进封装领域最重要的投资项目之一，亚利桑那州将通过该项目巩固其在半导体行业的世界领先地位。我很高兴与亚利桑那州商务主管部门和韩国 Amkor 领导层会面，讨论未来在亚利桑那州的投资，并且很自豪能与他们成为合作伙伴。我们将共同努力，继续扩大半导体生态系统，延续亚利桑那州在先进制造业领域的悠久领导地位。”

TSMC 首席执行官魏哲家博士表示：“Amkor 多年来一直是 TSMC 的 OSAT 战略合作伙伴。”“TSMC 对 Amkor 与我们一起在亚利桑那州投资半导体行业的未来表示赞赏。我们与 Amkor 一样，对其重大投资以及该工厂将为 TSMC、TSMC 客户和生态系统带来的价值感到十分激动。”

苹果公司首席运营官 Jeff Williams 表示：“苹果公司致力于在美国建立一个先进制造业的新时代。”“苹果和 Amkor 合作了十多年，Amkor 对苹果公司所有产品中广泛使用的芯片提供封装服务，我们很高兴这一合作关系将在美国最大的 OSAT 先进封装厂延续。”

Rutten 补充说：“这家美国新工厂将与我们遍布亚洲和欧洲的先进工厂相结合，进一步加强我们广泛的地理覆盖范围，不仅支持全球供应链，同时也促进区域供应链的发展。”“这项投资将巩固我们在所服务的主要市场中先进封装和测试领域的领先地位，同时巩固我们对扩大美国芯片制造的承诺。”

关于 Amkor Technology, Inc.

Amkor Technology, Inc. 自 1968 年成立以来，Amkor 一直是集成电路封装和测试外包的先驱者，目前是世界领先的半导体公司、晶圆厂和电子设备制造商的战略制造合作伙伴。Amkor 为通信、汽车和工业、计算和消费行业提供一站式制造服务，包括但不限于智能手机、电动汽车、数据中心、人工智能和可穿戴设备。Amkor 的经营场地包括位于亚洲、欧洲和美国主要电子制造地区的工厂设施、产品研发中心和销售及支持办公室。更多有关信息，请登录 amkor.com。

前瞻性免责声明

本新闻稿包含联邦证券法界定的前瞻性声明，包括有关 CHIPS 资金和政府支持的金额和时间、亚利桑那州的投产、设施的规模、产能、产量以及其他特点和优势、投资金额、供应链、创造就业、市场地位和增长。请注意，不要过分依赖前瞻性声明。本新闻稿中的所有前瞻性声明均基于我们当前的预期、预测、预估和假设。由于此类声明包含风险和不确定性，因此实际结果可能与此类前瞻性声明中的预期存在重大差异。可能影响这些声明中所列事件结果的风险因素包括但不限于：无法保证该工厂将如期按时间线、按成本或按规格建造；或完全无法保证该工厂将产生预期类型或数量的销售或其他收益；以及公司向美国证券交易委员会提交或提供的报告中讨论的其他因素。所有可归因于我们或代表我们行事的人员的前瞻性声明均受本警示性声明的明确限制。除非适用法律要求，否则我们没有义务审查或更新任何前瞻性声明以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况。

联系人

投资者关系

Jennifer Jue
投资者关系及财务副总裁
480-786-7594
jennifer.jue@amkor.com



新闻稿

媒体关系

Christina Parsons

总监，市场沟通部

480-786-7823

christina.parsons@amkor.com

社交媒体: @amkortechnology